

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成16年12月24日(2004.12.24)

【公開番号】特開2002-373871(P2002-373871A)

【公開日】平成14年12月26日(2002.12.26)

【出願番号】特願2001-181921(P2001-181921)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/301

【F I】

H 01 L	21/78	M
H 01 L	21/78	P
H 01 L	21/78	Q

【手続補正書】

【提出日】平成16年1月29日(2004.1.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0041

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0041】

本発明においては、研削工程又は／及びダイシング工程において、上記補強半導体ウエハ薄膜を研削用テープ又はダイシングテープに貼り付けた状態で加工する。上記補強半導体ウエハ薄膜を研削用テープ又はダイシングテープに貼り付けた状態としては、図1に示すように支持体が研削用テープ又はダイシングテープに接している様であってもよく、図2に示すように半導体ウエハが研削用テープ又はダイシングテープに接している様であってもよい。ただし、半導体ウエハの裏面が研削される際には支持体が研削用テープに接している様が好ましい。

上記研削用テープ又はダイシングテープとしては特に限定されないが、公知の光硬化性粘着テープを用いることができ、例えば、Adwin(登録商標)D-シリーズや、日東電工社製のエレップホルダー(登録商標)UEシリーズ等のテープが挙げられる。

また、公知の加熱発泡型粘着テープも用いられており、例えば、日東電工社製のリバアルファ(登録商標)が挙げられる。